電波新聞　日刊　土曜・日曜を除く

2014年(平成26年)9月17日(水曜日)

売上げが拡大する台湾市場

千住金属工業台湾　奥野將晴総経理に聞く

サプライチェーンと連携

はんだボールの開発進む

SEMIによると、13年のはんだボールの世界市場は2億8千万ドル。鉛フリーはんだボールの出荷が増加を続ける中、高度な実装工程が進む台湾が大きなシェアを占める。

14年売上げ2桁成長

そうした動きの中、千住金属工業（SMIC）台湾が順調に売上げを拡大している。奥野將晴総経理は「半導体パッケージング材料市場が良好なこともあり、14年の売上げは出荷台数で2桁の成長となるだろう」という。

奥野　総経理

2・5Dパッケージングが成長を続ける一方、3Dパッケージングフォームファクタにおける高密度化に対する要求に応えるため、シリコン貫通ビア（TSV）の開発が続く。

「しかし、これまでのところ、3D市場のニーズはアプリケーションを促進するまでには至っていない。商業的な成功は難しく、サプライチェーン間の協力や参加に頼っている。新たな市場で優位を占めるため、SMIC台湾はサプライチェーンと連携し、高い良品率と魅力的なコストのプロセスを開発、業界のロードマップを前進させている。例えば、早くから50ナノメートルはんだボールの開発をしてきた」と奥野総経理。

また、話題のウエアラブル機器については「iWatchが確実な機能でユーザーの関心を捉えるだろう。腕に着用する機器は、プロセッサや部品を高度に組み込む必要がある。我が社の3Dパッケージソリューションには、スペースの高さを制御する30―40ナノメートルのマイクロサイズボールや層間の電子移動、熱放熱を解決するため電気的接続、および機械的結合を提供する銅核はんだボールなどがある」と話している。

セミコン台湾で紹介

3―5日、台北で開催された「セミコン台湾2014」で同社は12インチウエハーの射出成形はんだ（IMS）ウエハーバンピングを紹介。

IBMと共同開発したはんだバンプ形成機は、低コスト、ボイドフリー、超微細なバンプ形成ができ、今日のフラックスレスプロセス方式に対応するとし、高い関心を集めた。

（台北支局）

日刊
電波新聞
発行所　電波新聞社
東京本社
東京都品川区東五反田1―11―15　〒141―8715
☎03(3445)6111(大代表)
大阪本社
大阪市中央区北浜3―2―25
(京阪淀屋橋ビル6階)　〒541―0041
☎06(6203)3361(大代表)
西部本社
福岡市博多区博多駅前2―13―23(扇寿ビル)　〒812―0011
☎092(431)7411(大代表)
©電波新聞社　2006